



LED Encapsulant- Elastomeric Silicone

JS-L04 AB kit

鉅升 JS-L04 AB kit 矽樹脂，廣泛用於電氣及電子工業，其獨特性質，包括極佳耐溼性、電絕緣性佳、優異熱安定性及極高離子純度。特別是，矽酮封裝劑用以改良電子裝置之可靠性，對環境潮溼、UV 輻射、二氧化硫、臭氧及惡劣環境條件下保持其物理特性和電學特性之保護，特別添加了無機觸媒，能增加其黏著強度。

鉅升 JS-L04 AB kit 矽樹脂封裝膠，被設計成用來滿足 LED 市場的需要，包括高粘著、高純度、耐濕氣、高穩定性。鉅升 JS-L04 AB Kit 材料固化後可以吸收封裝內部由於高溫循環引起的應力，追隨性佳而能保護晶片及其焊接金線。在電子工業迅速向無鉛製程發展中，鉅升封裝膠以其所展示的在焊錫回流溫度時的穩定性適合於 LED 應用。

1. 特性:

- 優異的高溫穩定性，在操作及性能上有更高的可靠性
- 抗 UV 能力佳
- One part 施工方便性佳 - 熱驅動聚合運送或儲存性優
- 濕氣攝取量低-在業界應用上有更高的可靠性
- 氣體穿透量低-防止銀的腐蝕
- 可調節之模量 - 設計靈活性
- 膨脹係數較小 - 高可靠度



- 低離子含量 - 不腐蝕電極
- 優異的光學特性 - 可以廣泛地匹配各種不同磊晶材料應用
- 加成固化 - 無副產物並且收縮性小
- 無溶劑 - 無危害性散發物

2. 固化前物性:

屬性	單位	方法	SRIM-L04 kit
單或雙組份	-	--	雙組份
Mix Ratio		1:1	
顏色	-	--	透明微乳白
A 劑黏度	Mpa. s	ASTM D2393	11500
B 劑黏度	Mpa. s	ASTM D2393	4900
混合黏度		1:1	6500
比重	-	ASTMD792	0.996
熱固化時間@150°C	Minutes	--	60
折射率@450nm		注	1.41
硬度	Shore "A"		65
絕緣強度	Volts/mil kV/mm	ASTM D149	475 19
體積阻抗	Ohm*cm	ASTM D257	1.4e15
線性膨脹係數	PPM/°C	TMA	250
450nm 透光率 (1mm)	%		94%

3. 固化條件:

- 3.1. 建議將 AB 膠以 1:1 的比例混合均勻。
- 3.2. 減壓抽氣，排除因攪拌所衍生的氣體。
- 3.3. LED 晶粒點完膠後，減壓排氣。
- 3.4. 建議固化溫度 110°C 30min → 150°C 3hr.



4. 使用方式操作注意事項:

表面應清潔乾燥，推薦的清潔方法包括：幹式電漿清洗乙及溼式石腦油、溶劑油、甲基乙基酮（MEK）或其他合適的溶劑。粗糙的表面有助於促進矽酮與其它表面的粘合。LED 矽酮材料被特別設計用於常用的 LED 基材，特別的表面處理如化學酸洗或電漿處理，有時可以提供活性表面以及促進這類基材的粘合。通常，增加固化溫度和/或固化時間將會增加強粘合。

5. 相容性注意事項:

某些材料、化學製劑、固化劑和增塑劑會抑制加成固化。這些最值得注意的物質包括：

- 有機錫和其他有機金屬化合物
- 含有機錫催化劑的矽橡膠
- 硫、聚硫化物、聚砜類物或其他含硫材料
- 胺聚氨酯橡膠或者含氮的材料
- 不飽和烴增塑劑
- 某些助焊劑殘留物

如果對某一種基材或材料是否會抑制固化存在疑問，建議先做一個小規模相容性測試來確定某一種特定應用的合適性。如果在有疑問的基材和固化了的凝膠介面之間存在液體或者未固化的產品，說明不相容物質會抑制固化。



6. 注意事項:

處理該產呂建議裝戴防護眼鏡和防護手套。保持工作場所良好的通風。

7. 儲存和保質期:

6 個月，製造日期標示在產品標籤上，膠水須採取特別的預防措施來防止物品接觸濕氣。容器要保持密封。

8. 包裝:

100g; 500g; 1000g 玻璃瓶裝，本公司保有包裝的變更權。

9. 客製化服務:

本公司生產各種各樣的 LED 匹配封裝膠，來滿足大多數應用和工藝的需求，我們持續不斷地擴大我們的產品種類來確保生產出您需要的特殊產品。但是，如果您沒有找到正好符合您需要的產品，可以通過我們的快速配程序改進我們現有的產品來滿足您的需要。這裡有幾個快速配方的例子，包括：改進產品的固化時間、模量、粘度、折射率。

10. 限制:

本產品不能用於醫療或藥品上運用。